

2013年11月1日

# 2014年3月期 第2四半期 決算説明会

代表取締役社長  
山口 悟郎

京セラ株式会社

# 本日の説明内容

**1. 2014年3月期上期 決算概要**

**2. 2014年3月期通期 業績予想**

# 1. 2014年3月期上期 決算概要

# 2014年3月期上期 決算概要（前年同期比）

（単位：百万円）

	2013年3月期 上期		2014年3月期 上期		増 減	
	金 額	売上高比 (%)	金 額	売上高比 (%)	金 額	率 (%)
売 上 高	608,431	100.0	699,663	100.0	91,232	15.0
営 業 利 益	25,891	4.3	58,203	8.3	32,312	124.8
税引前四半期純利益	35,732	5.9	69,053	9.9	33,321	93.3
当社株主に帰属する 四半期純利益	25,371	4.2	42,930	6.1	17,559	69.2
設 備 投 資 額	26,526	4.4	28,607	4.1	2,081	7.8
減 価 償 却 費	28,684	4.7	29,873	4.3	1,189	4.1
研 究 開 発 費	23,866	3.9	24,180	3.5	314	1.3
平均為替レート	ドル	79円	99円			
	ユーロ	101円	130円			
為替変動による 影響額 (前年同期比)	売上高	約 -125億円	約 790億円			
	税引前 四半期純利益	約 -55億円	約 160億円			

# 2014年3月期上期 事業セグメント別売上高（前年同期比）

（単位：百万円）

■ 事業セグメント	2013年3月期 上期		2014年3月期 上期		増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
■ ファインセラミック部品関連事業	38,399	6.3	38,187	5.5	-212	-0.6
■ 半導体部品関連事業	82,483	13.6	87,063	12.4	4,580	5.6
■ ファインセラミック応用品関連事業	85,424	14.0	127,515	18.2	42,091	49.3
■ 電子デバイス関連事業	140,815	23.1	147,451	21.1	6,636	4.7
<b>部品事業 計</b>	<b>347,121</b>	<b>57.0</b>	<b>400,216</b>	<b>57.2</b>	<b>53,095</b>	<b>15.3</b>
■ 通信機器関連事業	84,333	13.9	96,557	13.8	12,224	14.5
■ 情報機器関連事業	116,787	19.2	144,525	20.7	27,738	23.8
<b>機器事業 計</b>	<b>201,120</b>	<b>33.1</b>	<b>241,082</b>	<b>34.5</b>	<b>39,962</b>	<b>19.9</b>
■ その他の事業	74,861	12.3	79,713	11.4	4,852	6.5
調整及び消去	-14,671	-2.4	-21,348	-3.1	-6,677	-
<b>売上高</b>	<b>608,431</b>	<b>100.0</b>	<b>699,663</b>	<b>100.0</b>	<b>91,232</b>	<b>15.0</b>

## 2013年3月期上期 事業セグメント別事業利益（前年同期比）

（単位：百万円）

■ 事業セグメント	2013年3月期 上期		2014年3月期 上期		増減	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	金額	率(%)
■ ファインセラミック部品関連事業	4,535	11.8	5,762	15.1	1,227	27.1
■ 半導体部品関連事業	13,862	16.8	16,041	18.4	2,179	15.7
■ ファインセラミック応用品関連事業	5,288	6.2	14,834	11.6	9,546	180.5
■ 電子デバイス関連事業	-11,879	-	14,662	9.9	26,541	-
<b>部品事業 計</b>	<b>11,806</b>	<b>3.4</b>	<b>51,299</b>	<b>12.8</b>	<b>39,493</b>	<b>334.5</b>
■ 通信機器関連事業	801	0.9	266	0.3	-535	-66.8
■ 情報機器関連事業	11,106	9.5	10,449	7.2	-657	-5.9
<b>機器事業 計</b>	<b>11,907</b>	<b>5.9</b>	<b>10,715</b>	<b>4.4</b>	<b>-1,192</b>	<b>-10.0</b>
■ その他の事業	4,345	5.8	2,001	2.5	-2,344	-53.9
<b>事業利益 計</b>	<b>28,058</b>	<b>4.6</b>	<b>64,015</b>	<b>9.1</b>	<b>35,957</b>	<b>128.2</b>
本社部門損益等	7,674	-	5,038	-	-2,636	-34.3
<b>税引前四半期純利益</b>	<b>35,732</b>	<b>5.9</b>	<b>69,053</b>	<b>9.9</b>	<b>33,321</b>	<b>93.3</b>

## 2014年3月期上期 決算要約（前年同期比）

### 前年同期比大幅な増収増益

**売上高：前年同期比 +912億円（+15.0%）**

- 太陽電池の需要増によるファインセラミック応用品関連事業の大幅な増収（+421億円）
- 情報機器関連事業の複合機及びプリンターの販売台数の増加及び円安の効果による増収（+277億円）
- 通信機器関連事業の米国市場での販売拡大による増収（+122億円）
- スマートフォン向け部品売上の増加による半導体部品関連事業及び電子デバイス関連事業の増収（+112億円）

**税引前利益：前年同期比 +333億円（+93.3%）**

- AVXの環境汚染浄化費用を前年同期に計上、加えて原価低減等による電子デバイス関連事業の大幅な利益改善（+265億円）
- ソーラーエネルギー事業、機械工具事業の増収効果、及び原価低減によるファインセラミック応用品関連事業の大幅増益（+95億円）

## 2. 2014年3月期通期 業績予想



# 2014年3月期通期 業績予想

(単位:百万円)

	2013年3月期		2014年3月期				増減金額	
			前回予想 (2013年4月公表)		今回予想 (2013年10月公表)			
	金額	売上高比 (%)	金額	売上高比 (%)	金額	売上高比 (%)	前期比	前回予想比
売上高	1,280,054	100.0	1,400,000	100.0	1,430,000	100.0	149,946	30,000
営業利益	76,926	6.0	140,000	10.0	140,000	9.8	63,074	—
税引前当期純利益	101,363	7.9	150,000	10.7	150,000	10.5	48,637	—
当社株主に帰属する 当期純利益	66,473	5.2	96,000	6.9	96,000	6.7	29,527	—
希薄化後1株当たり当社株主に 帰属する当期純利益* (円)	181.18	—	261.67	—	261.67	—	80.49	—
設備投資額	56,688	4.4	75,000	5.4	75,000	5.2	18,312	—
減価償却費	63,119	4.9	74,000	5.3	74,000	5.2	10,881	—
研究開発費	47,519	3.7	52,000	3.7	52,000	3.6	4,481	—
平均為替レート	対ドル: 83円	対ユーロ: 107円	対ドル: 96円*	対ユーロ: 124円*	対ドル: 98円	対ユーロ: 130円	* 本年8月に 平均為替レート予想を変更	

(注) 1 2014年3月期業績予想の希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、2014年3月期上期の希薄化後の期中平均発行済株式数を用いて算出しています。  
2 希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、2013年10月1日に実施した株式分割を、2013年3月期の期首(2012年4月1日)に実施したと仮定し算出しています。

# 2014年3月期通期 事業セグメント別売上高予想

(単位:百万円)

■ 事業セグメント	2013年3月期		2014年3月期 予想				増減金額	
			前回予想 (2013年4月公表)		今回予想 (2013年10月公表)			
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	前期比	前回 予想比
■ ファインセラミック部品関連事業	74,852	5.9	82,500	5.9	82,500	5.8	7,648	—
■ 半導体部品関連事業	167,241	13.1	192,500	13.8	199,000	13.9	31,759	6,500
■ ファインセラミック応用品関連事業	211,439	16.5	227,000	16.2	257,000	18.0	45,561	30,000
■ 電子デバイス関連事業	271,570	21.2	282,000	20.1	282,000	19.7	10,430	—
<b>部品事業 計</b>	<b>725,102</b>	<b>56.7</b>	<b>784,000</b>	<b>56.0</b>	<b>820,500</b>	<b>57.4</b>	<b>95,398</b>	<b>36,500</b>
■ 通信機器関連事業	177,314	13.8	191,000	13.6	193,000	13.5	15,686	2,000
■ 情報機器関連事業	250,534	19.6	280,000	20.0	290,000	20.3	39,466	10,000
<b>機器事業 計</b>	<b>427,848</b>	<b>33.4</b>	<b>471,000</b>	<b>33.6</b>	<b>483,000</b>	<b>33.8</b>	<b>55,152</b>	<b>12,000</b>
■ その他の事業	159,902	12.5	176,000	12.6	173,000	12.1	13,098	-3,000
調整及び消去	-32,798	-2.6	-31,000	-2.2	-46,500	-3.3	-13,702	-15,500
<b>売上高</b>	<b>1,280,054</b>	<b>100.0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>100.0</b>	<b>1,430,000</b>	<b>100.0</b>	<b>149,946</b>	<b>30,000</b>

# 2014年3月期通期 事業セグメント別利益予想

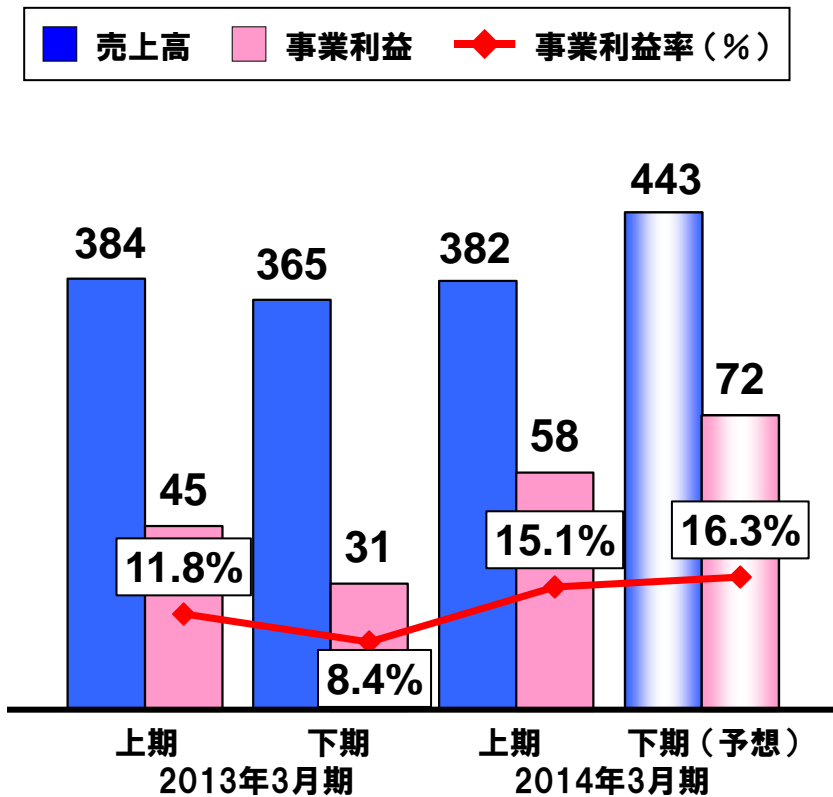
(単位:百万円)

■ 事業セグメント	2013年3月期		2014年3月期				増減金額	
			前回予想 (2013年4月公表)		今回予想 (2013年10月公表)			
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	前期比	前回予想比
■ ファインセラミック部品関連事業	7,614	10.2	12,000	14.5	13,000	15.8	5,386	1,000
■ 半導体部品関連事業	30,379	18.2	36,000	18.7	32,000	16.1	1,621	-4,000
■ ファインセラミック応用品関連事業	17,924	8.5	24,000	10.6	29,600	11.5	11,676	5,600
■ 電子デバイス関連事業	-4,014	-	28,200	10.0	28,000	9.9	32,014	-200
<b>部品事業 計</b>	<b>51,903</b>	<b>7.2</b>	<b>100,200</b>	<b>12.8</b>	<b>102,600</b>	<b>12.5</b>	<b>50,697</b>	<b>2,400</b>
■ 通信機器関連事業	1,340	0.8	6,400	3.4	5,000	2.6	3,660	-1,400
■ 情報機器関連事業	21,750	8.7	28,000	10.0	25,000	8.6	3,250	-3,000
<b>機器事業 計</b>	<b>23,090</b>	<b>5.4</b>	<b>34,400</b>	<b>7.3</b>	<b>30,000</b>	<b>6.2</b>	<b>6,910</b>	<b>-4,400</b>
■ その他の事業	10,542	6.6	8,600	4.9	6,400	3.7	-4,142	-2,200
<b>事業利益 計</b>	<b>85,535</b>	<b>6.7</b>	<b>143,200</b>	<b>10.2</b>	<b>139,000</b>	<b>9.7</b>	<b>53,465</b>	<b>-4,200</b>
■ 本社部門損益等	15,828	-	6,800	-	11,000	-	-4,828	4,200
<b>税引前当期純利益</b>	<b>101,363</b>	<b>7.9</b>	<b>150,000</b>	<b>10.7</b>	<b>150,000</b>	<b>10.5</b>	<b>48,637</b>	<b>-</b>

# 2014年3月期 事業セグメント別下期業績予想

## ファインセラミック部品関連事業

(単位:億円)



### 当上期比 増減

売上高	+61億円 (+16.0%)
事業利益	+14億円 (+25.6%)

### 下期の取組み

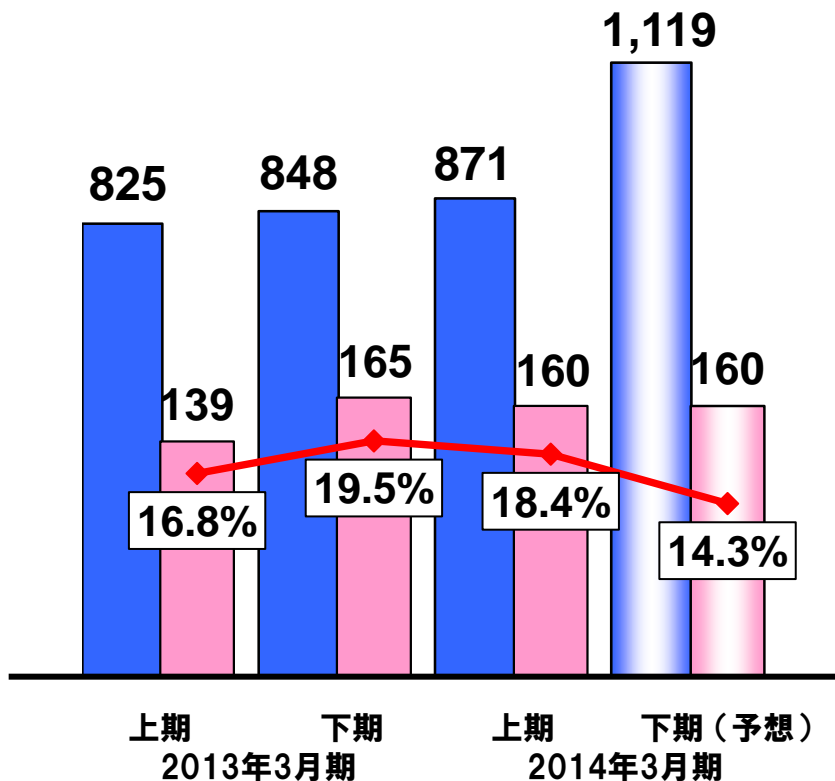
- 半導体製造装置用部品等、産業機械市場向け部品の受注獲得
- 生産性向上による収益性改善

# 2014年3月期下期 事業セグメント別業績予想

## 半導体部品関連事業

(単位:億円)

■ 売上高 ■ 事業利益 ◆ 事業利益率(%)



### 当上期比 増減

売上高	+248億円 (+28.6%)
事業利益	-0億円 (-0.5%)

### 下期の取組み

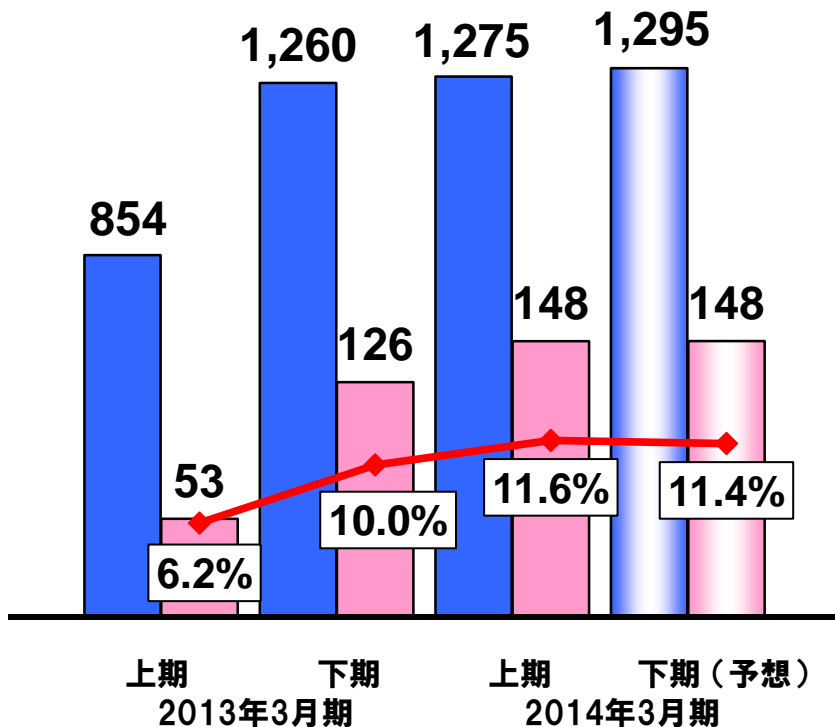
- スマートフォンを中心とするデジタル  
コンシューマ機器用パッケージの拡販
- 京セラサーキットソリューションズ(株)の  
新規売上貢献
- ベトナム新工場での生産増

# 2014年3月期下期 事業セグメント別業績予想

## ファインセラミック応用品関連事業

(単位:億円)

■ 売上高 ■ 事業利益 ◆ 事業利益率 (%)



当上期比 増減	
売上高	+20億円 (+1.5%)
事業利益	-0億円 (-0.5%)

### 下期の取組み

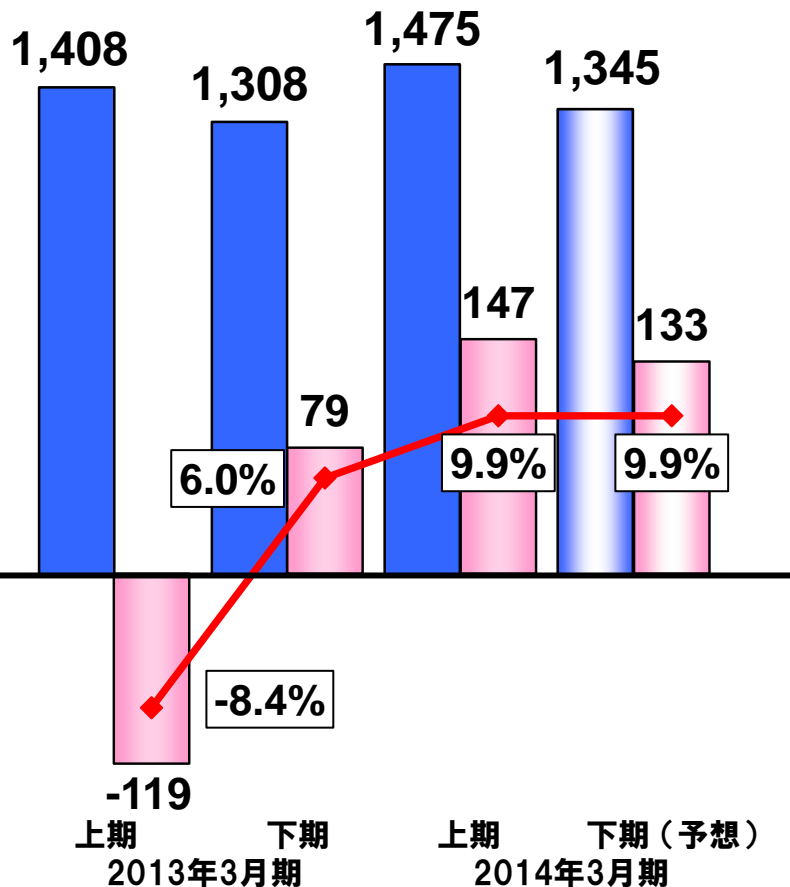
- ソーラーエネルギー事業の国内市場での売上拡大及びアジア等の海外市場の開拓
- 新興国での機械工具事業の売上拡大

# 2014年3月期下期 事業セグメント別業績予想

## 電子デバイス関連事業

(単位：億円)

■ 売上高 ■ 事業利益 ◆ 事業利益率(%)



### 当上期比 増減

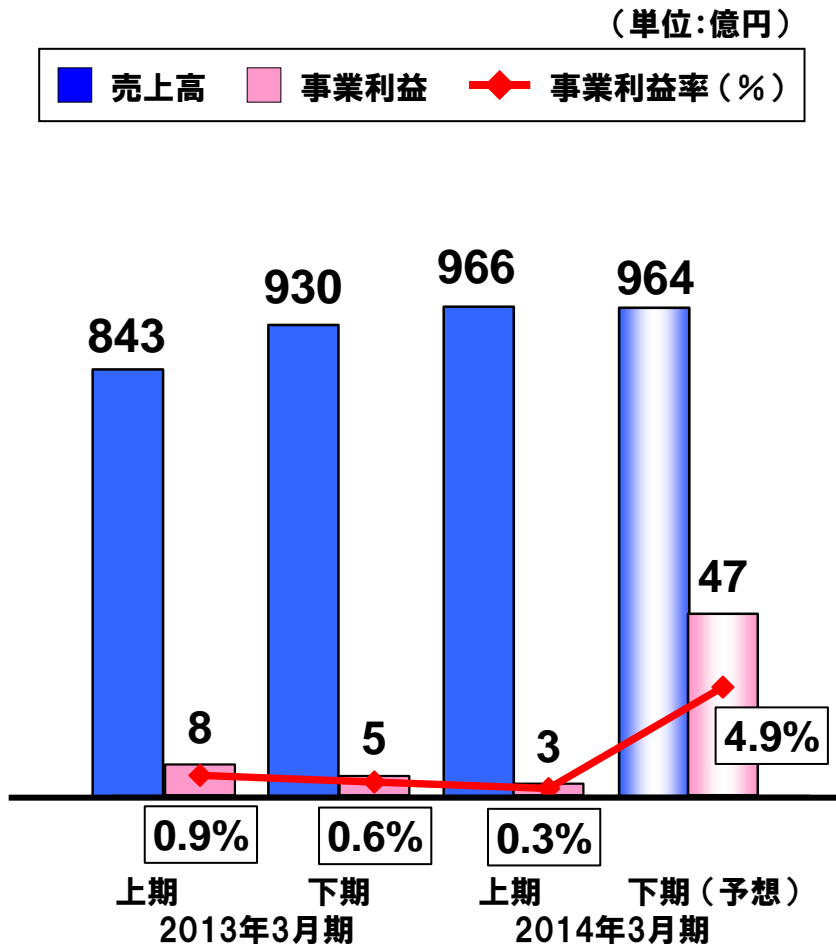
売上高	-130億円 (-8.8%)
事業利益	-14億円 (-9.0%)

### 下期の取組み

- スマートフォンを中心とするデジタル  
コンシューマ機器向けや、自動車及び  
産業機械市場向け部品の拡販
- 高付加価値製品の拡販及び原価低減  
による収益性の向上
- ベトナム新工場でのコネクタの生産拡大

# 2014年3月期下期 事業セグメント別業績予想

## 通信機器関連事業



当上期比 増減	
売上高	-2億円 ( -0.1%)
事業利益	+44億円 ( - )

### 下期の取組み

- 国内外での差別化製品のラインナップの拡充による売上拡大
- 北米市場でのさらなる新規キャリアの獲得

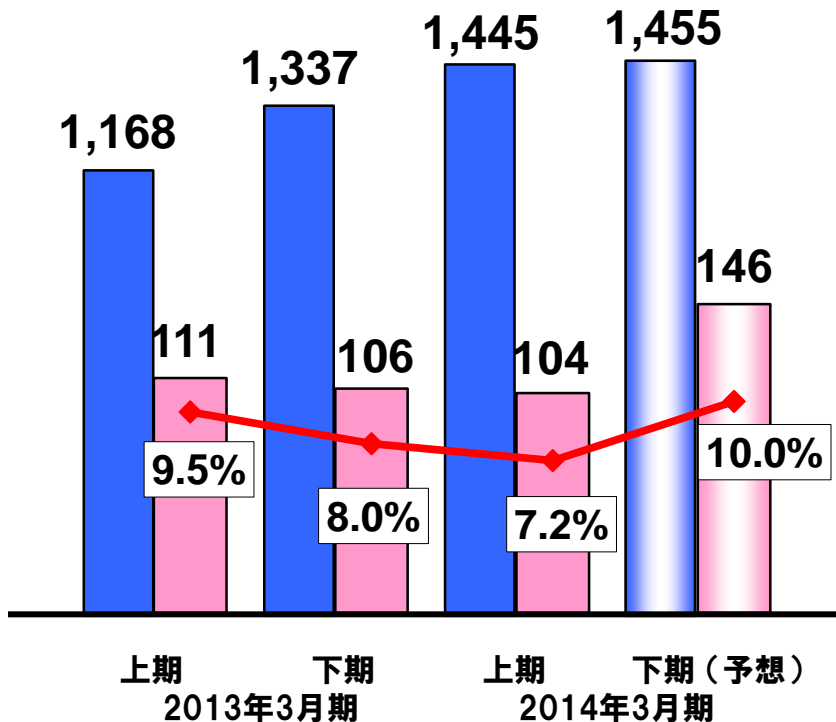


# 2014年3月期下期 事業セグメント別業績予想

## 情報機器関連事業

(単位:億円)

■ 売上高 ■ 事業利益 ◆ 事業利益率 (%)



### 当上期比 増減

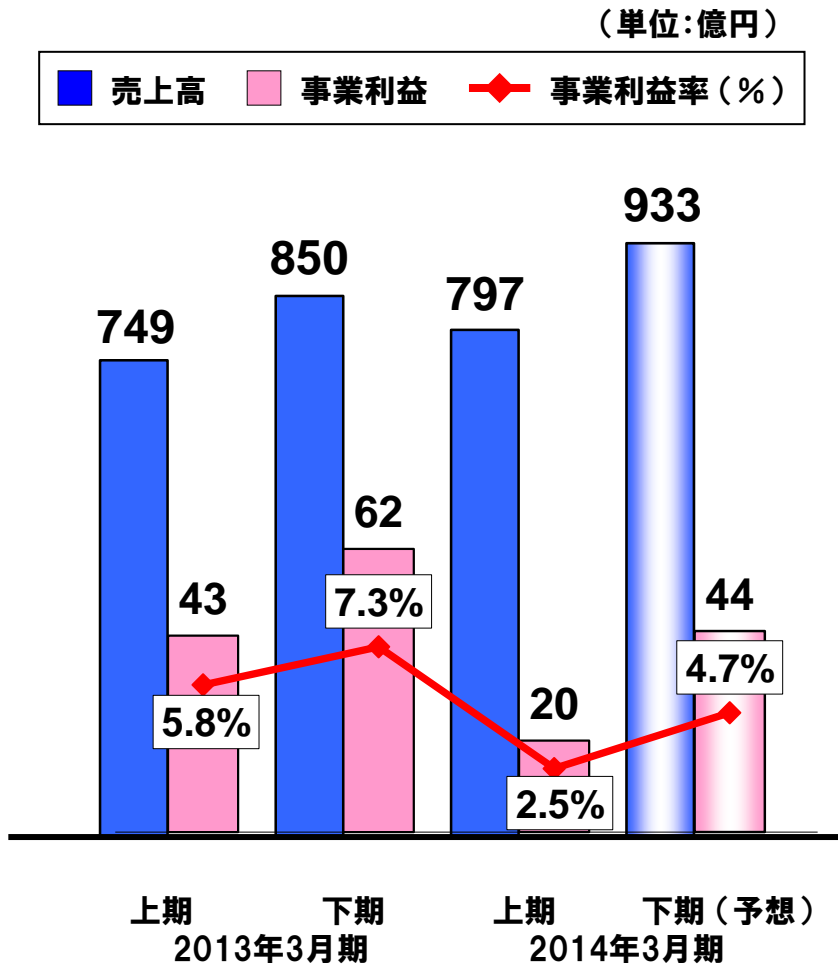
売上高	+10億円 ( +0.7%)
事業利益	+42億円 (+39.3%)

### 下期の取組み

- 中高速機等の新製品の拡販による販売増加及び新興国での売上増加
- ベトナム工場での生産拡大及び原価低減の推進

# 2014年3月期下期 事業セグメント別業績予想

## その他の事業



当上期比 増減	
売上高	+136億円 ( +17.0%)
事業利益	+24億円 (+119.8%)

### 下期の取組み

- 京セラコミュニケーションシステム(株)でのICT事業及びエンジニアリング事業等の受注獲得

## 2014年3月期の重点課題

### ■ 経営基盤の強化

- 技術優位性を活かした国内での生産拡大
- 原価低減及び需要増に対応した海外での生産拡大

### ■ 成長市場での売上拡大

- 環境・エネルギー市場
- 情報通信市場

## 経営基盤の強化

### 期初の計画通り、国内外での生産体制の拡大を推進

#### 国内での生産拡大

##### ➤ 有機パッケージ生産工場の増設

- 本年5月着工、2014年夏稼働予定



京都府綾部工場

##### ➤ トナー生産工場の増設

- 本年5月着工、2014年6月稼働予定



三重県玉城工場

写真は完成予想図

#### 海外での生産拡大

##### ➤ ベトナム新工場での生産開始

- 本年8月よりセラミックパッケージの生産開始
- 本年11月よりコネクタの生産開始予定



ベトナム新工場(タンロン)

##### ➤ インド新工場での生産開始

- 本年12月より切削工具の生産開始予定



インド新工場(ジャムシェドプール)

# 成長市場での売上拡大（1）-環境・エネルギー市場-

## 環境・エネルギー関連事業の売上拡大

- ▶ 小型案件から太陽光発電システムの販売、設計、施工、保守まで含むメガソーラー等の大規模案件までの受注獲得による売上拡大



小型ソーラー発電施設



完成予想図

鹿児島七ツ島メガソーラー発電所

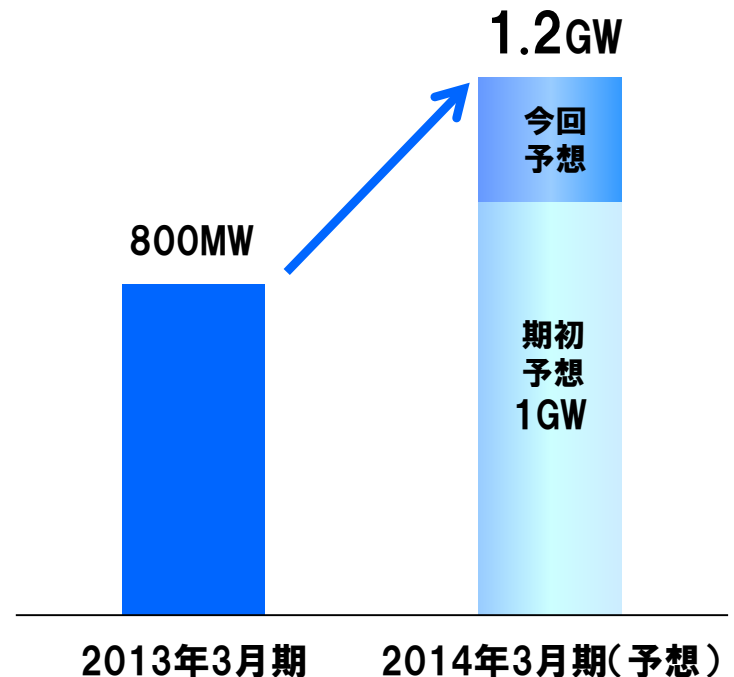
- ▶ 今後成長が見込まれるアジア等の海外市場開拓



当社製太陽電池を使用したタイの大規模ソーラー発電所

### 京セラの太陽電池出荷量

期初計画を  
20%程度上回る見込み



# 成長市場での売上拡大(2) -情報通信市場①- 通信機器関連事業の売上拡大

## 米国市場

- ベライゾン・ワイヤレス社へ供給開始

### Hydro ELITE

#### 差別化機能

スマートソニック  
レシーバー



防水



- さらなる新規キャリアの獲得を目指す

## 国内市場

- フィーチャーフォンからスマートフォンまで特長ある新製品を市場投入

スマートソニックレシーバー

防水

防塵  
耐衝撃  
大容量バッテリー

大容量バッテリー  
急速充電

134g  
最軽量\*



MARVERA



URBANO L01



DIGNO® M

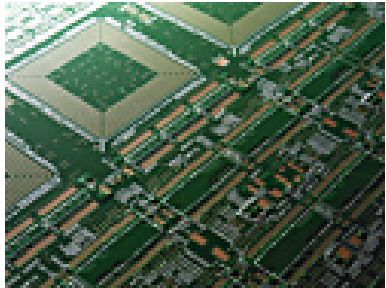
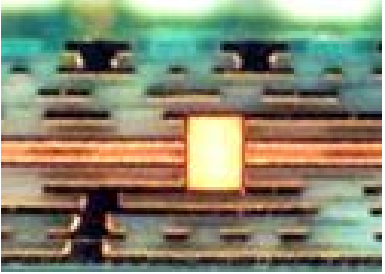
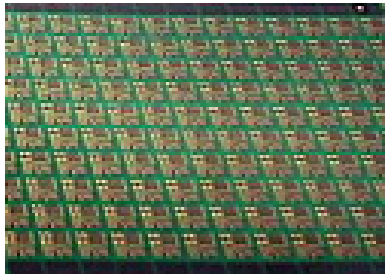
\* 国内における2,600mAh以上の電池と5インチディスプレイを搭載した防水対応のスマートフォンにおいて、2013年10月1日現在、京セラ調べ。

# 成長市場での売上拡大(3) - 情報通信市場② -

## 有機基板事業の強化

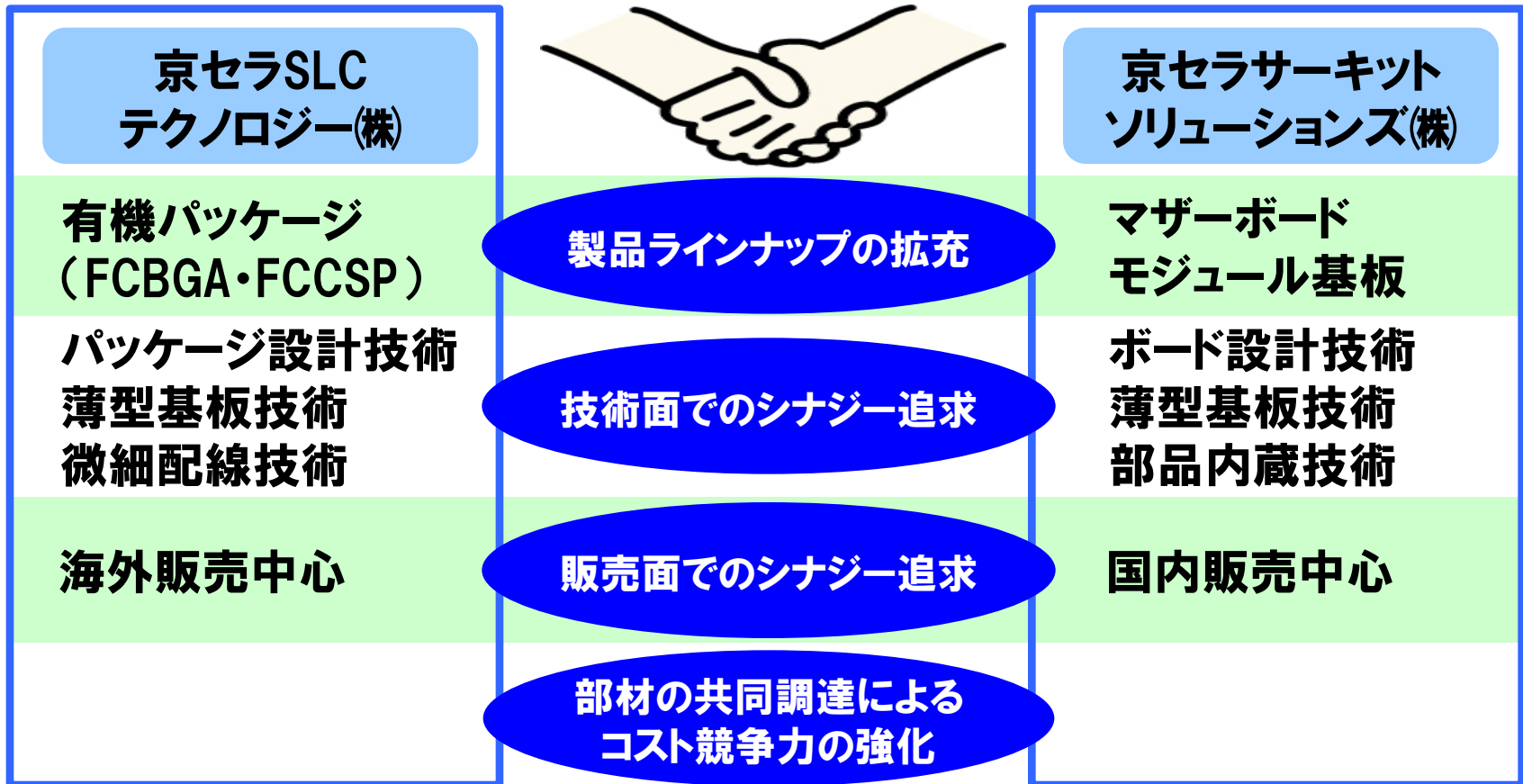
(株)トッパンNECサーキットソリューションズ(現京セラサーキットソリューションズ(株))  
を本年10月1日に100%子会社化

### 京セラサーキットソリューションズ(株)の概要

本社	東京都港区
事業内容	<p>産業用高多層基板、民生用ビルドアップ基板、モジュール基板の開発／製造／販売</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>高多層基板</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ビルドアップ基板</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>モジュール基板</p> </div> </div>
連結従業員数	1,119名(2013年10月1日時点)
主要拠点	<p>製造拠点:新潟、富山、フィリピン 販売拠点:東京、大阪、名古屋、サンノゼ、サンディエゴ</p>

# 有機基板事業の拡大

パッケージから基板までの製品供給体制の強化により  
マーケットリーダーを目指す



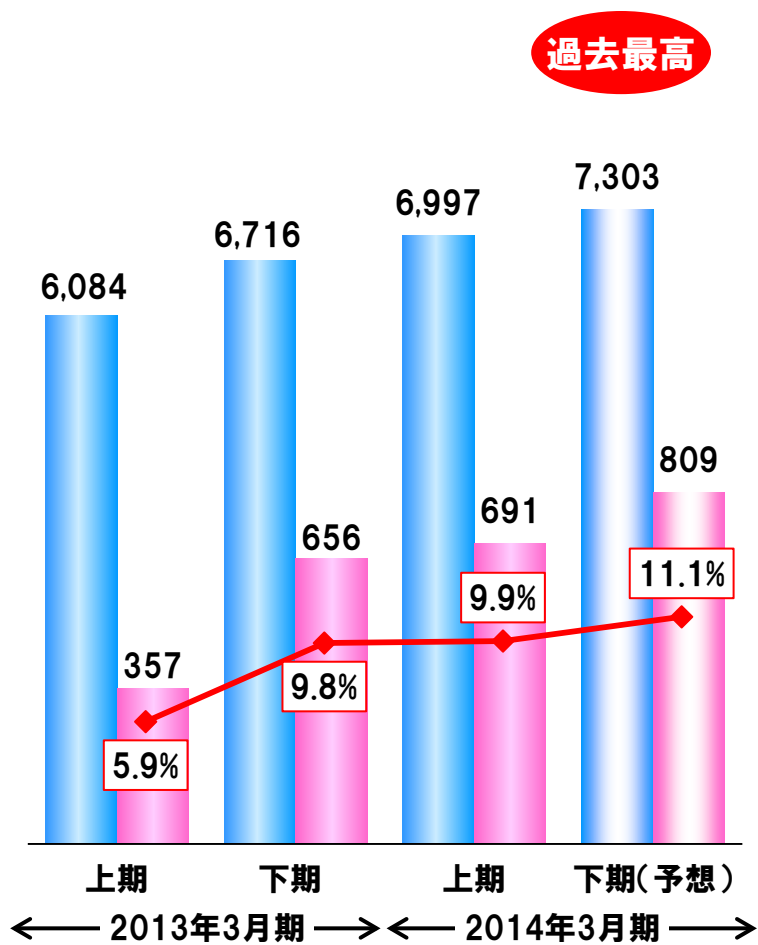
**早期に1,000億円の売上規模を目指す**



# 2014年3月期 業績予想

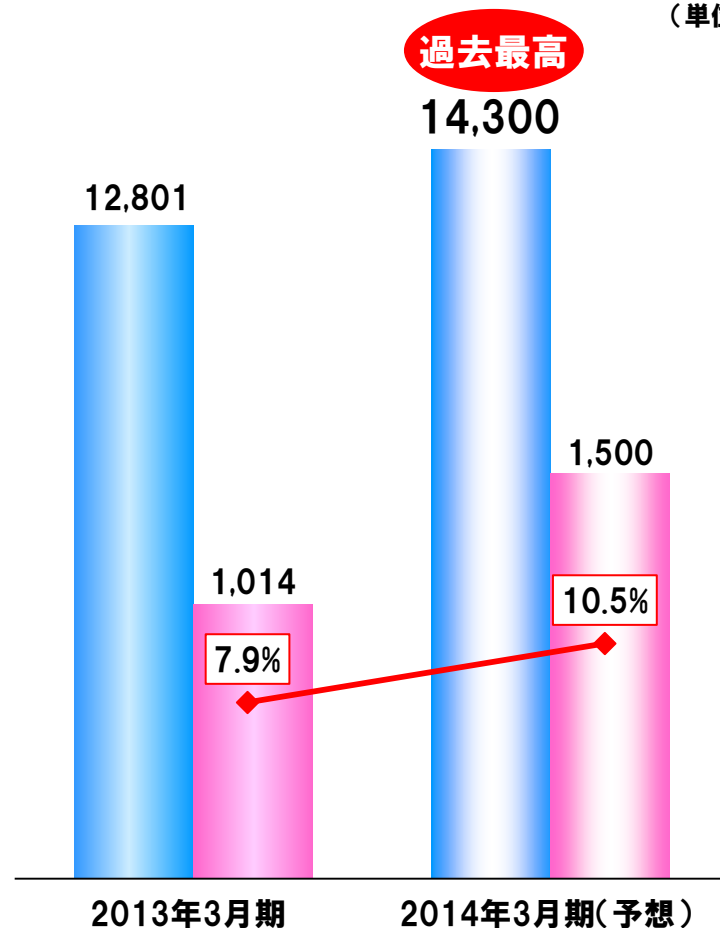
## 半期業績推移

■ 売上高 ■ 税引前利益 ◆ 税引前利益率  
(単位:億円)



## 通期業績推移

■ 売上高 ■ 税引前利益 ◆ 税引前利益率  
(単位:億円)

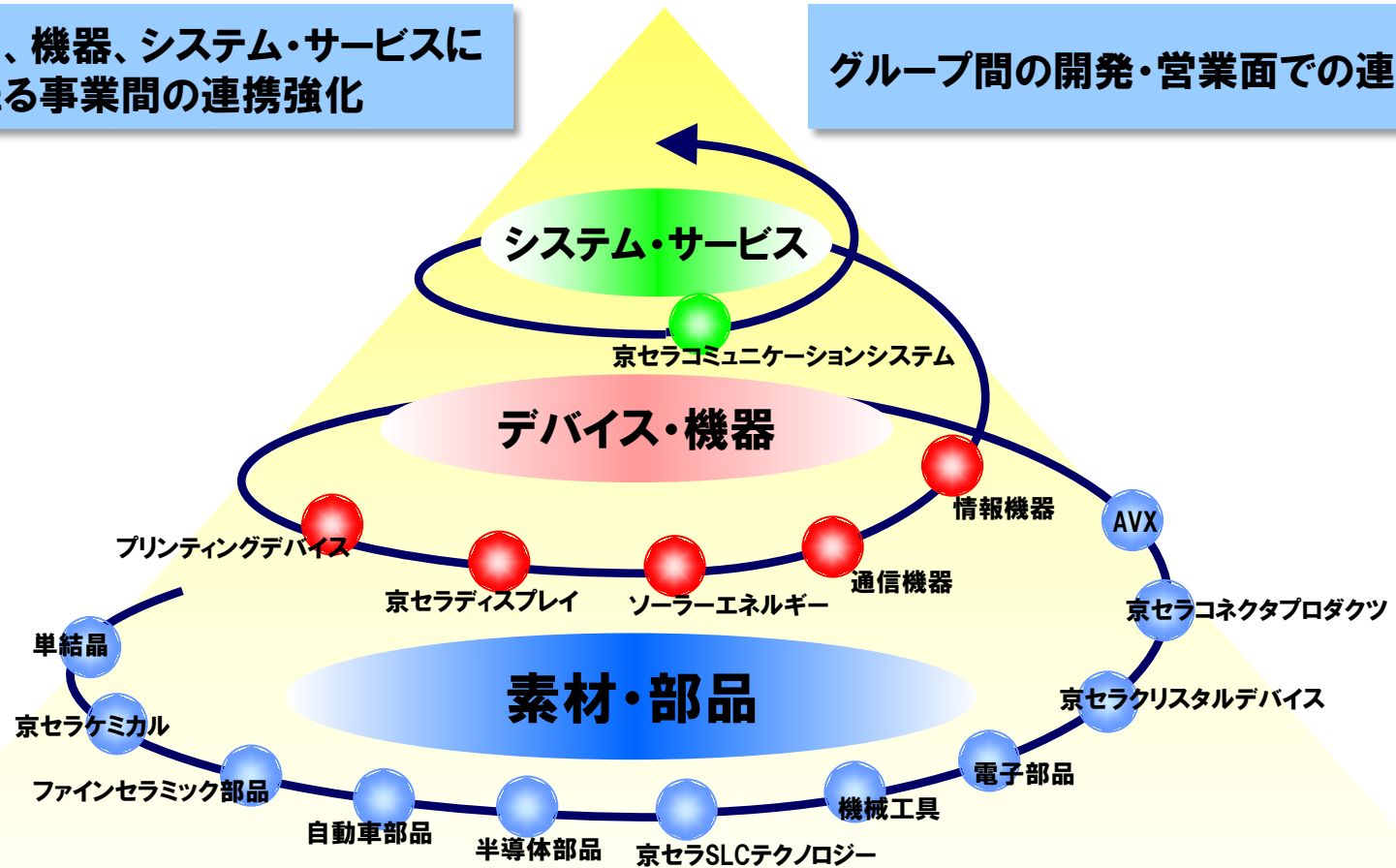


# 京セラグループ 経営方針

グループの総合力により「高成長・高収益企業」を目指す

素材、部品、機器、システム・サービスにわたる事業間の連携強化

グループ間の開発・営業面での連携強化



新製品開発の強化

シェアアップ

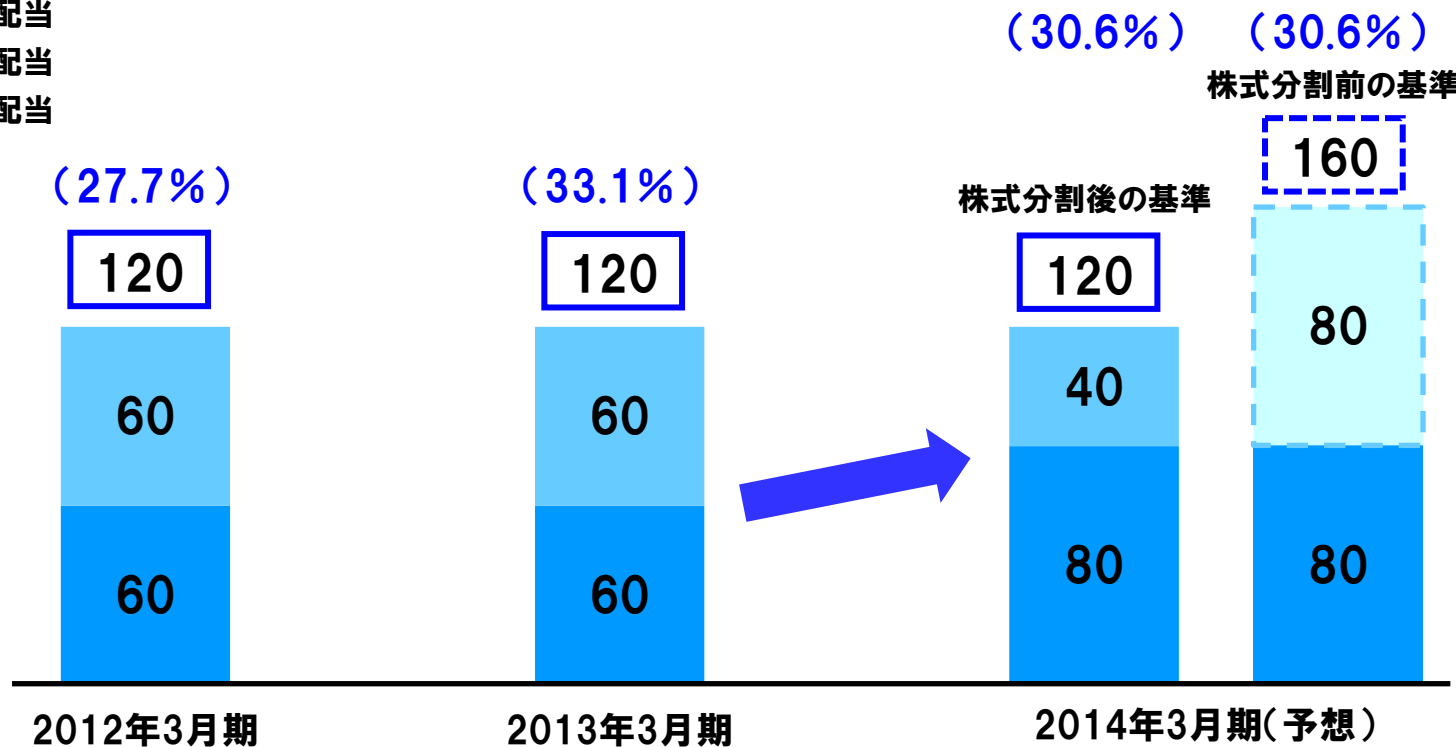
## 株主還元強化

- 今期より配当方針を変更：連結配当性向30%以上の水準で維持
- 株式分割の実施(10月1日)：1株を2株へ分割
- 当期中間配当金は前年同期比20円増配の1株当たり80円
- 分割後の当期期末当金は40円(株式分割前の基準で80円)を予想

### 1株当たり配当金の推移

(単位：円)

- ( ) 年間配当性向
- 年間配当
- 期末配当
- 中間配当



## 将来予想に関する注意事項

この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。かかる将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものです。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。(1) 当社の主要市場である日本、北米、欧州及びアジアの経済状況。(2) 当社が事業を行う国及び地域における経済・政治・法律面の諸条件及びその想定外の変化。(3) 円高、政治・経済情勢、関税及び不十分な知的財産権等の保護等が当社製品の輸出に及ぼす影響。(4) 為替レートの変動が当社の海外資産の価値又は製品価格に及ぼす影響。(5) 製品価格、技術革新、製品開発、品質、納期等の面における競争の激化。(6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延又は不良の発生。(7) 電力不足や電力費の上昇が当社の生産活動及び販売活動に及ぼす影響。(8) 生産及び開発能力の拡大又は現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない事態。(9) 買収した会社又は取得した資産から期待される成果や事業機会が得られない事態。(10) 科学技術分野等の優れた人材の確保が困難となる事態。(11) 当社の企業秘密が漏洩又は知的財産権が侵害される事態。(12) 当社が知的財産権侵害に関連する要求又は特許実施許諾料の請求を受ける可能性。(13) 国内外の環境規制による賠償責任の発生及び関連費用の負担。(14) 意図しない法規制への抵触又は想定していない法規制の導入が当社の事業活動を制約する状況。(15) テロ行為、疾病の発生等が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす悪影響。(16) 地震等の自然災害及びこれに付随する災害によって当社の事業関連施設、サプライヤー及び顧客、並びに社会資本及び経済基盤等が甚大な被害を受ける事態。(17) 当社の顧客の財政状態の悪化により売掛債権の回収が困難となる事態。(18) 当社が保有する投資有価証券等の時価の下落に伴う減損処理の可能性。(19) 当社の長期性資産、営業権、無形資産の減損処理の可能性。(20) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性。(21) 会計基準の変更。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、これらの将来予想に関する記述に明示又は黙示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。